

# 300X300Mm 가열 플레이트와 프로그래밍 가능한 Pid 제어 기능을 갖춘 중장비 40톤 분리형 자동 핫 프레스

품목 번호: XP39



## 소개

300x300mm 플레이트, 독립 듀얼 PID 온도 제어, 다단계 압착 사이클, 40톤 유압, CE 인증을 갖춘 중장비 40톤 분리형 자동 핫 프레스. 실험실 압착, 분말 야금, 배터리 연구, 세라믹 소결에 적합합니다.

## 자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
첨단 세라믹 핫 프레스 소결	알루미나, 지르코니아, 질화규소, 탄화붕소 분말을 고성능 부품으로 고밀도화. 균일한 온도장은 차등 고밀도화 및 입자 성장을 방지합니다.	균질한 미세 구조와 최소 내부 응력으로 이론적 밀도에 근접.
분말 야금 성형	철, 스테인리스강, 텅스텐 카바이드, 티타늄 합금 분말을 고강도 생坯(그린 빌렛)로 사전 소결 성형.	생坯 밀도를 극대화하여 소결 수축을 줄이고 더 엄격한 치수 공차를 가능하게 함.
전고체 배터리 전극 적층	고체 전해질 시트와 복합 전극의 핫 프레스로 다층 셀에서 계면 저항을 최소화하고 박리를 방지.	고 이온 전도도와 긴 사이클 수명을 위한 고품질, 결함 없는 계면 생성.
고성능 폴리머 성형 및 필름 적층	연료전지 부품 또는 플렉서블 전자제품용 PTFE, PEEK, PVDF 및 다층 필름의 압축 성형 및 적층.	공극을 제거하고 치수 안정성과 일관된 층간 접착력을 보장.
복합재료 통합	항공우주 패널 및 자동차 부품용 섬유 강화 열가소성 또는 열경화성 프리프레그의 핫 프레스. 프로그래밍 가능 압력 프로파일은 섬유 유실 및 적층체 공극을 방지합니다.	예측 가능한 기계적 특성을 가진 저기공율, 고강도 적층체 생산.
전자 패키징 및 봉지	정밀한 온도와 압력 하에서 인쇄 회로 기판 또는 반도체 기판 위에 봉지재 필름 적층.	우수한 접착력으로 공극 없는 봉지를 달성하여 장치 신뢰성 향상.
금속 기지 복합재(MMC) 처리	세라믹 입자 또는 섬유로 강화된 알루미늄, 구리 또는 마그네슘 기지 복합재의 핫 성형.	무게가 중요한 응용 분야를 위한 균질성 및 기계적 특성 향상.
타이어 및 고무 시편 제작	고무 화합물을 압축 가황시켜 기계적 특성 평가용 시험 시트 또는 소형 성형품 제작.	ASTM 및 ISO 시험 표준을 충족하는 일관되고 결함 없는 샘플 생산.

사양	값
모델	XP39
유형	분리형 자동 핫 프레스
압력 범위	0 - 40톤
플레이트 크기	300 × 300 mm
최대 작업 온도	0 - 300 °C
가열 출력	4,800 W (2 × 2,400 W)

사양	값
온도 제어	PID 지능형 프로그래밍 가능, 독립 듀얼 채널
압력 제어	PID 자동 프로그램 홀드/정압, 다단계 시간 자동 해제
피스톤 스트로크	50 mm
최대 테이러이트 개방	150 mm
냉각 방식	순환 수냉 (외부 냉각기 옵션); 퀵 커넥트 커플링 제공
제어 인터페이스	7인치 고해상도 산업용 터치스크린
전원 공급	AC 220V / 50Hz, 단상 (최대 21.8A, 공기 차단기 필요)
치수 (대략)	800 × 440 × 620 mm (확인 필요)
순중량 (대략)	420 kg (확인 필요)
인증	CE